

EIGNUNGSMATRIX UNSERER OBERFLÄCHEN

	CHEM. NI/AU ENIG	CHEM. NI/PD/AU ENEPIG	CHEM. PD/ AU EPIG	DIRECT GOLD DIG	GALV. NI/ HARTGOL D	GALV. NI/ FEINGOLD	CHEM. ZINN	HAL BLEIFREI	HAL SNPB	CHEM. SILBER
Beschreibung	Reduktiv Nickel/ Immersion Gold	Reduktiv Nickel/ Reduktiv Palladium/ Immersion Gold	Reduktiv Palladium/ Teilreduktives Gold	Teilreduktives Gold	Steck- kontakte			Hot Air Leveling (Heißluf- terzinnung)	Hot Air Leveling (Heißluf- terzinnung)	
Layer und Schichtdicke	Ni: 4-7µm Au: 0,05-0,1µm	Ni: 4-7µm Pd: 0,1-0,3µm Au: 0,03-0,3µm	Pd: 0,1-0,3µm Au: 0,1-0,3µm	Au: 0,2-0,3µm	Ni: >4µm Au: 0,8-3µm	Ni: >4µm Au: 0,2-10µm	Sn: 1µm	SnCuNi-Leg 1-50µm	SnPb-Leg 1-50µm	Ag: 0,2µm
Löten	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲
Bonden Al-Draht	▲	▲	▲	▲	✖	▲	✖	✖	✖	▲
Bonden Au-Draht	▼	▲	▲	▲	✖	▲	✖	✖	✖	▲
Hochfrequenz	●	●	▲	▲	●	▲	●	●	●	▲
Lagerfähigkeit	>12 MONATE	>12 MONATE	>12 MONATE	>12 MONATE	>12 MONATE	>12 MONATE	6 MONAT E	>12 MONAT E	>12 MONATE	6 MONATE
Einpresstechnik	●	●	▲	▲	●	●	▲	▲	▲	●
Korrosions- beständigkeit	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	●
Preis	●	●	▼	▼	●	●	▲	▲	▲	▲
RoHS	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	✖	▲

▲-uneingeschränkt ▲-gut durchführbar ●-mit Einschränkung ▼-stark limitiert ✖-ungeeignet